



2023年10月31日

各 位

会 社 名 丸 文 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 飯 野 亨
(コード番号 7537 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 渋 谷 敏 弘
(電話番号 03-3639-3010)

**2024年3月期第2四半期業績予想と実績との差異および
通期業績予想の修正に関するお知らせ**

当社は、2023年5月12日に公表した2024年3月期第2四半期連結累計期間業績予想値と本日公表の実績値に差異が生じたのでお知らせいたします。また、最近の業績動向等を踏まえ、2024年3月期通期連結業績予想を修正いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第2四半期連結累計期間業績予想値と実績値の差異 (2023年4月1日～2023年9月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 四半期純利益	1株当たり 四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	113,500	3,400	1,300	645	24.68
実績(B)	123,729	7,342	2,080	1,137	43.51
増減額(B-A)	10,229	3,942	780	492	
増減率(%)	9.0	115.9	60.0	76.3	
(ご参考) 前期 第2四半期実績 (2023年3月期 第2四半期)	101,022	5,267	1,135	469	17.97

2. 連結業績予想の修正 (2023年4月1日～2024年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	236,000	8,750	5,000	3,000	114.79
今回修正予想(B)	240,000	12,500	5,000	3,000	114.75
増減額(B-A)	4,000	3,750	0	0	
増減率(%)	1.7	42.9	0.0	0.0	
(ご参考) 前期 実績 (2023年3月期)	226,171	10,997	7,909	5,201	199.04

3. 差異及び修正の理由

2024年3月期第2四半期連結累計期間の業績につきましては、デバイス事業で民生機器向け半導体の需要が大幅に伸長し、自動車向けや産業機器向け半導体の需要も想定を上回る水準で推移しました。またシステム事業でも産業機器分野が堅調に推移したため、売上高は前回予想を上回りました。営業利益は、デバイス事業で円安進行により円換算ベースの売上総利益が押し上げられたため、前回予想を大幅に上回る結果となりました。一方、期初からの円安進行に伴い、外貨建て借入の返済に伴う期中での決済差損や第2四半期末における外貨建て借入の評価による評価損が発生し営業外費用（為替差損）を計上しましたが、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益ともに前回予想を上回りました。

2024年3月期通期の業績につきましては、第2四半期連結累計期間までの業績の進捗状況を踏まえ、売上高及び営業利益を上記の通り修正いたします。なお経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、前回予想から変更はありません。

(注) 上記の業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。

以 上